

Feingold-und Feinsilberbäder zur Abscheidung von bondfähigen Schichten für die Elektronik?



1 Einleitung Der Begriff Bonden stammt aus dem angelsächsischen Sprachraum und bedeutet verschweißen bzw. verbinden. Gemeint sind elektrische Verbindungen in der Elektronik, wobei Funktionsflächen auf einem Substrat oder Träger mit aufgesetzten Bauelementen verknüpft werden. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen. Man kennt das Chip-Bonden oder DIE-Bonden, wobei ein Silizium-Chip mit einer galvanischen vergoldeten Oberfläche durch die Bildung eines niedrigschmelzenden Au/Si-Eutektikums mit der Unterlage verlötet oder durch einen Leitkleber befestigt wird. Im letzten Fall kann auch galvanisch abgeschiedenes Silber als Basis dienen. Von großer Bedeutung sind die Drahtbondverfahren zur Verbindung von Funktionsflächen auf Chips mit Kontaktflächen auf Lead frames oder Leiterplatten. Diese Bondverfahren basieren hauptsächlich auf der Verwendung von Gold- oder Aluminiumdrähten, die die Verbindungen zu den Einzelementen über z.B. dort aufgebrachte Edelmetallschichten herstellen. Einzelheiten über verschiedene Drahtbondverfahren gehen aus dem Merkblatt DVS 2810 (Drahtbonden) des Deutschen Verbandes für Schweißtechnik e.V. hervor [1]. Verschiedene Testmethoden für Bonds sind in Military Standard MIL-STD- 883 B beschrieben [2]. Eine generelle Übersicht gibt [16].

Rating: Not Rated Yet

Price

Price with discount: 3,18 €

3,18 €

Sales price without tax: 3,18 €

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)